

IEEE EDS Japan Joint Chapter 会員各位  
IEEE EDS Kansai Chapter 会員各位  
IEEE SSCS Japan Chapter 会員各位  
IEEE SSCS Kansai Chapter 会員各位

IEEE Electron Devices Society Japan Joint Chapter  
Chair 西山 彰  
Vice Chair 平本 俊郎

### IEEE EDTM 報告会開催のお知らせ

2019年3月にシンガポールで行われましたIEEE EDS, 3rd Electron Devices Technology and Manufacturing (EDTM) Conference 2019 (<http://ewh.ieee.org/conf/edtm/2019/>)について下記の通り、日本語による報告会を開催致します。奮って御参加下さい。

なお、次回は2020年3月16日から18日にマレーシア・ペナン島で開催される予定で、論文投稿締め切りは2019年9月27日です。

IEEE Xploreに掲載され、J-EDS special issue も発行される予定です。  
<http://ewh.ieee.org/conf/edtm/2020/>

\*\*\*\*\* IEEE EDTM 2019 報告会 詳細 \*\*\*\*\*

- 主催：IEEE EDS Japan Joint Chapter および EDTM2019 委員会
- 日時：2019年7月12日金曜日 13:30-17:20
- 会場：東京工業大学 すすかけ台キャンパス G2 棟 501 号室  
<https://www.titech.ac.jp/maps/suzukakedai/>
- 参加費：無料、どなたでも参加可能です。

■ プログラム：

13:30-13:40	EDTM2019 概要説明	石丸 一成・東芝メモリ
13:40-14:10	Subcommittee on Si Devices 概要	齋藤 真澄・東芝メモリ
14:10-14:40	Subcommittee on Process 概要	三浦 真・日立ハイテクノロジーズ
14:40-15:10	Subcommittee on Modeling 概要	Dondee Navarro・広島大学
15:10-15:30	休憩	
15:30-16:00	Subcommittee on Package 概要	栗田 洋一郎・東芝
16:00-16:30	Subcommittee on Material 概要	若林 整・東京工業大学
16:30-16:55	共催 CREST/WS 概要	若林 整・東京工業大学
16:55-17:00	EDTM2020 の紹介	石丸 一成・東芝メモリ
17:00	終了	

■ お問い合わせ先：

石丸 一成 (東芝メモリ)  
[kazu.ishimaru@toshiba.co.jp](mailto:kazu.ishimaru@toshiba.co.jp)  
三谷 祐一郎 (東芝メモリ)  
[yuuichiro.mitani@toshiba.co.jp](mailto:yuuichiro.mitani@toshiba.co.jp)

IEEE EDS Japan Chapter ホームページ：  
<http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>